全球及中国智能终端高性能合封芯片产业发展分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：智能终端高性能合封芯片概述
第2章：全球智能终端高性能合封芯片市场分析
2.1 全球智能终端高性能合封芯片发展概况
2.2 全球智能终端高性能合封芯片市场规模
第3章：中国智能终端高性能合封芯片市场分析
3.1 中国智能终端高性能合封芯片应用分析
3.2 中国智能终端高性能合封芯片市场规模
3.3 中国智能终端高性能合封芯片竞争格局
第4章：智能终端高性能合封芯片市场趋势与前景分析
第5章：中国智能终端高性能合封芯片重点企业发展概况
5.1 深圳宇凡微电子有限公司（宇凡微）
5.2 芯海科技（深圳）股份有限公司（芯海科技）
5.3 中微半导体（深圳）股份有限公司（中微半导）
5.4 上海芯圣电子股份有限公司（芯圣电子）
5.5 上海晟矽微电子股份有限公司（晟矽微电子）

图表目录

图表1：智能终端高性能合封芯片应用优势
图表2：2020-2023年全球智能终端出货规模（单位：亿台）
图表3：2022-2023年全球智能终端高性能合封芯片市场规模情况（单位：亿元）
图表4：2020-2023年中国智能终端出货规模（单位：亿台）
图表5：2013-2023年中国集成电路（芯片）产量（单位：亿块，%）
图表6：2013-2023年中国集成电路（芯片）市场规模（单位：亿元，%）
图表7：2022-2023年中国智能终端高性能合封芯片市场规模（单位：亿元）
图表8：2024-2029年全球智能终端高性能合封芯片市场前景预测（单位：亿元）
图表9：2024-2029年中国智能终端高性能合封芯片市场前景预测（单位：亿元）
图表10：深圳宇凡微电子有限公司基本工商信息
图表11：深圳宇凡微电子有限公司智能终端高性能国产合封芯片业务
图表12：芯海科技（深圳）股份有限公司基本工商信息
图表13：芯海科技（深圳）股份有限公司智能终端高性能国产合封芯片业务
图表14：中微半导体（深圳）股份有限公司基本工商信息
图表15：中微半导体（深圳）股份有限公司智能终端高性能国产合封芯片业务
图表16：上海芯圣电子股份有限公司基本工商信息
图表17：上海芯圣电子股份有限公司智能终端高性能国产合封芯片业务
图表18：上海晟矽微电子股份有限公司基本工商信息
图表19：上海晟矽微电子股份有限公司智能终端高性能国产合封芯片业务

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！